

これからの材料開発の在り方 —熱を制御するセラミックス—(仮)

●日時 2018年2月26日(月) 10:00~16:45 終了後18:30まで交流会
(受付は9:40より開始いたします。)

●会場 大阪産業創造館 6階 会議室E (地下鉄堺筋本町駅より徒歩5分 大阪市中央区本町1-4-5)

●主催 ニューセラミックス懇話会・(一社)大阪府技術協会

●後援 (地独)大阪産業技術研究所

●協賛

日本セラミックス協会、日本セラミックス協会関西支部、日本ファインセラミックス協会、ファインセラミックスセンター、粉体粉末冶金協会、日本物理学会、応用物理学会、日本機械学会、日本ロボット学会、電気学会、電気化学会、日本材料学会、日本真空学会、日本真空学会関西支部、近畿化学協会、電子情報技術産業協会関西支部、KEC 関西電子工業振興センター、大阪工研協会、日本電子材料技術協会、センシング技術応用研究会、岡山セラミックス技術振興財団、大阪府電磁波利用技術研究会、京都セラミックフォーラム、滋賀材料技術フォーラム、未踏科学技術協会、九州ファインセラミックス・テクノフォーラム、電池技術委員会、日本自動車工業会、固体イオニクス学会、電気化学会関西支部、日本熱電学会 (依頼中を含む)

◆参加申込方法

下記申込書をFAXしていただくか、申込書と同一内容(①~③)をe-mailでお送り下さい。参加費は、開催日前日までに銀行振込か下記申込み先へ現金書留郵送にてお支払い下さい。なお、払い込み済の参加費は返却いたしません。

◆参加費・定員60名

主催団体会員 15,000円 ※今回新たに入会された方を含む
協賛団体会員 15,000円
一般 20,000円

◆参加費振込先(振込手数料はご負担下さい)

三菱東京UFJ銀行 光明池(こうみょういけ)支店 普通 3927160
口座名 ニューセラミックス懇話会 会長 和田隆博
(ニューセラミックスコンワカイ カイチョウ ワダタカヒロ)

◆お申込み・お問い合わせ先

ニューセラミックス懇話会事務局

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ2-7-1(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター内
TEL 0725-53-1919 FAX 0725-53-2332
e-mail newceramicsf@dantai.tri-osaka.jp
URL http://tri-osaka.jp/dantai/ncf/



第45回ニューセラミックスセミナー参加申込書

送り先 FAX 0725-53-2332 または e-mail newceramicsf@dantai.tri-osaka.jp

所属	①会社名	連絡先	④住所
	②所属部課名		⑤電話 ⑥FAX
参加者	③氏名	参加費	⑦e-mail
	(以下、2人目以降の氏名)		⑧交流会(参加費無料・参加人数把握のため) ⑨参加区分
			⑩参加費合計 (円) × (名) = 円
			⑪送金方法 銀行振込(月 日振込予定) 現金書留
			⑫請求書 要 不要
			⑬領収書 要 不要

⑭ニューセラミックス懇話会会員以外のかたへ

ご記入いただいた内容は、本セミナーの参加申込み手続きを目的として収集しており、漏洩のないよう厳重に管理します。なお、今後ニューセラミックス懇話会主催行事への案内に利用する場合がありますが、案内が不要な場合は、右を○で囲んでください。

案内不要

●プログラム

10:00～10:05	開会挨拶
10:05～10:55	講演(1) 自動車の熱管理技術と課題 トヨタ自動車(株) 車両技術開発部 熱・流体技術開発室 プロフェッショナル・パートナー 松野 孝充 氏
11:05～11:55	講演(2) パワーモジュールにおけるセラミックス材料の開発のトレンド (仮題) 三菱電機(株) 西村 隆 氏
11:55～12:50	昼食休憩
12:50～13:40	講演(3) 高放熱基板の技術動向 (仮題) デンカ(株) 廣津留 秀樹 氏
13:50～14:40	講演(4) AI・機械学習の発展とデータ駆動型マテリアルズ・インフォマティクスへの展開 (仮題) (株)日立製作所 淺原 彰規 氏
14:50～15:40	講演(5) 将来のセラミック材料の研究開発に向けて (株)村田製作所技術・事業開発本部 新規技術センター 先端技術研究開発部 プリンシパルリサーチャー 檜貝 信一 氏
15:50～16:40	講演(6) データ駆動型手法による新規熱電変換材料の発見とその第一原理材料設計 パナソニック(株) 先端研究本部 材料・デバイス研究室 主任研究員 玉置 洋正 氏
16:40～16:45	閉会挨拶
17:00～18:30	交流会 (参加無料)